

部品内蔵基板対応の表面実装技術

境 忠彦*

JISSO Technology for “Device Embedded Substrate”

Tadahiko SAKAI*

* パナソニックファクトリーソリューションズ株式会社技術統括部材料開発部 (〒 561-0854 大阪府豊中市稲津町 3 丁目 1 番 1 号)

* Materials Development Department, Corporate Technology Division, Panasonic Factory Solutions Co., Ltd. (3-1-1 Inazu, Toyonaka City, Osaka 561-0854)